

证券代码： 301369

证券简称： 联动科技

佛山市联动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号： 投 2024-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国泰君安证券 舒迪、刘校、龙小琴
时间	2024 年 8 月 30 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、副总经理兼董事会秘书 邱少媚女士； 2、证券事务代表 梁韶娟女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、 公司基本情况介绍</p> <p>（1）主营产品介绍</p> <p>公司成立于 1998 年，一直专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研发、生产和销售。公司具备较为完善的产品线，主要包括半导体自动化测试系统、半导体激光打标设备、其他机电一体化设备，此外还有相应配件、维修服务等。公司的半导体自动化测试系统主要用于检测晶圆以及芯片的功能和性能参数，包括功率半导体的测试、模拟类及数模混合信号类集成电路的测试；激光打标设备主要用于半导体芯片的打标。</p> <p>成立后，公司推出首款激光打标设备，主要用于半导体分立器件的打标。得益于优异的产品性能，迅速得到了半导体封测客户的认可。而后凭借激光打标设备积累的客户资源、封测产线应用经验以及工业控制技术，公司自 2003 年起即开始进入分立器件测试系统领域，通过多年深耕封测行业的经验与技术积累，目前已经拥有自主研发的功率半导体及小信号分立器件测试系统产品包括 QT-3000/4000/5000/6000/8400 系列，涵盖小信号分立器件及中高功率半导体测试，包括二极管、三极管、MOSFET、IGBT、</p>

可控硅、SiC 和 GaN 第三代半导体等，以及功率模块的晶圆测试、KGD 测试及出厂测试，并已实现了产品的国际化布局。特别是公司 QT-4000 系列功率器件综合测试平台，主要针对功率器件测试，能满足高压源、超大电流源等级的功率器件测试要求，能够实现半导体器件直流参数测试项目和动态参数测试项的一对一数据合并，同时能够分别实现小信号分立器件和中大功率器件的多工位并行测试要求，带来测试精度、测试效率及数据分析管理效率的大大提高，顺应了市场变化趋势，深受市场主流功率半导体客户的认可，是公司销量较高的产品之一。

随着功率器件 CP 测试（晶圆测试）的需求逐渐增多，为了提升测试效率，客户对测试系统的并行测试能力不断提高。针对功率半导体和第三代半导体器件测试带来的新的测试需求，公司推出了新产品 QT-8400 系列功率测试平台，主要用于 IGBT 及第三代半导体碳化硅和氮化镓功率器件和晶圆测试及功率模块的全性能测试，能够满足电动汽车、新能源等工业领域日益增长的测试需求和新的应用场景。

（2）产品应用环节

公司产品主要应用于半导体生产前道工序中的晶圆测试环节，以及后道工序中框架或裸晶激光打标、KGD 测试、成品测试、激光打标/视觉检测等环节。KGD 测试是新的工艺技术环节，随着制造成本的提升和合封器件的应用，功率器件 CP 测试（晶圆测试）的需求逐渐增多，半导体测试越来越注重每一环节的可靠性，从而保证良率、降低成本。这些新的市场变化也将为测试设备企业带来更大的业务需求及市场空间。

经过多年的发展，公司及子公司已在佛山、上海、成都、苏州、无锡、北京、马来西亚等代表性市场区域建立起推广及服务网点，业务领域覆盖华南、华东、华北、西南、东南亚等主要市场。近几年，随着新能源、电动汽车等行业快速发展带来的新的应用领域的发展，公司的客户结构也有发生一些变化，以前以半导体封测厂商客户为主，现在以 IDM 模式的功率半导体厂商客户为主。

公司拥有一支优秀的人才队伍，截至 2024 年 6 月 31 日，公司研发人员 257 人，占员工总数的 38.07%，至今仍不断发展壮大。

二、问答环节

1、请介绍公司 2024 年 1-6 月经营情况？

回复：在收入方面，2024 年 1-6 月公司实现营业收入 1.36 亿元，同比增长 19.3%，主要来源于公司半导体自动化测试系统业务的增长。报告期内公司半导体自动化测试系

统产品收入占比 89.62%，受行业复苏的带动，下游客户设备需求有所增加，相关产品签单较为稳健，维持稳定增长。

在利润方面，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 278.36 万元，同比减少 1,602.44 万元，降幅 85.20%，具体原因主要有以下两点，其一是报告期内研发投入金额达到 5,609.05 万元，较去年同期增加 1,799.55 万元，增幅 47.24%；其二是公司实施 2023 年限制性股票激励计划，相比去年同期增加 1,282.56 万元的股份支付费用。剔除股份支付费用影响后，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,560.92 万元，同比下降 17.01%。

总体上来看，随着行业景气度筑底回升，2024 年上半年公司业绩进入恢复期，盈利能力逐季改善，2024 年二季度单季度实现收入 7,876.74 万元，环比增长 36.66%；归属于上市公司股东的净利润 609.92 万元，环比增长 283.95%。

2、请问公司对今年行业的看法及未来展望？

回复：整体来看，目前半导体行业正迎来回暖，逐渐步入复苏轨道，我们对未来行业的发展持乐观态度。中国半导体自动化测试市场呈现健康发展的态势，预计未来几年中国市场需求将保持稳定。一方面，由于全球人工智能、高性能运算等需求的爆发增长，随着 AI（人工智能）技术在终端应用领域的加速落地，相关产品 AI 功能及技术的不断进化，以及智能手机、个人计算机、服务器及汽车需求回升带动，未来有望带动新一轮行业增长周期；另一方面，随着功率半导体在新能源汽车、智能电网、工业自动化等领域的应用不断扩大，对功率半导体测试系统的需求也将持续增加。

3、请问公司今年上半年产品价格趋势如何？

回复：总体来看，2024 年上半年行业整体还处于周期底部，客户端对成本方面的要求越来越高，对设备价格的调整也是不可避免的，因此公司产品销售价格有所下滑。未来公司会通过设备配置的优化、供应链的整合和生产管理的加强来减少下游客户传导来的价格压力。同时，我们将继续提升产品的技术竞争力，随着未来公司对新产品新应用的加大推广以及技术迭代升级，也将有助于维系和提高相关产品的平均销售价格。

4、请问公司对新产品有什么规划及重要进展？

回复：公司未来新产品的规划方向主要为应用于大功率器件相关高压大电流以及动态参数的测试、数字/数模混合集成电路的半导体自动化测试系统，相关的研发项目均正在有序推进，其中面向数字及部分 SoC 类芯片的测试需求的大规模数字集成电路测试系统研发项目，已在硬件系统完善和软件应用系统的开发方面取得较大进展，正在进行

	<p>硬件架构进一步细化和软件应用系统的持续开发。</p> <p>5、公司在研的下一代大规模数模混合信号测试系统和大规模数字集成电路测试系统与现有的功率半导体测试系统产品在技术设计上主要有什么区别？</p> <p>回复：测试范围与功能是测试机的重要参数，不同类型的半导体器件具有不同的功能和性能特点。公司集成电路测试系统是在功率半导体测试系统的技术储备和应用积累上推出的产品，是半导体测试（电性能）的其中一个细分市场。与功率半导体侧重于高压大电流的技术要求不同，集成电路芯片由于体积较小，电流电压一般较小，但由于芯片种类较多、引脚数相对分立器件较多，功能测试较多，测试系统技术重点为测试系统模拟和数字的测试范围和测试精度，以及测试资源的同步和响应能力，因此，集成电路测试系统需要较大的技术架构和更多的功能模块，公司在研的下一代大规模数模混合信号测试系统和大规模数字集成电路测试系统具备更多的测试资源和开放式应用平台满足不同种类集成电路的测试要求，公司希望在此方面实现突破。</p> <p>6、请问公司签署订单后客户支付预付款的比例是多少？从产品销售下单到收入实现的时间间隔有多久？</p> <p>回复：公司目前各客户支付的预付款比例根据商务谈判情况而不同。一般是安装调试完毕后，由客户进行量产试用，设备的测试指标、可靠性、稳定性满足要求后，客户验收合格，公司确认销售收入的实现。一般情况下，公司整机产品从发货到验收的时间为 3-6 个月，但由于受到客户投产计划、生产进度、内部验收流程等因素的影响，各产品发货至验收的周期有所波动。2024 年上半年，由于市场行情及需求仍在温和复苏阶段，且功率半导体测试系统由于产品功能模块较多，生产和验收周期均有所延长，导致整体上产品从签订合同到收入确认的时间跨度波动相对较大。</p> <p>7、公司有无回购股份用于员工股权激励的打算？</p> <p>回复：股权激励可以充分调动员工的积极性和创造性，与员工分享公司的经营成果，有利于稳定核心员工和提高公司的经营状况。公司已于 2024 年 2 月推出了股份回购方案，目前回购计划正在推进中，回购股份将用于日后实施股权激励或员工持股计划。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 8 月 30 日